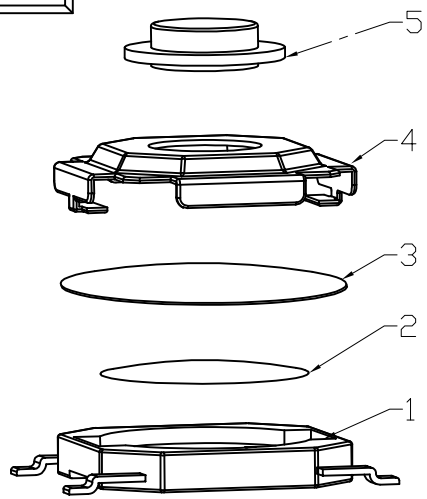
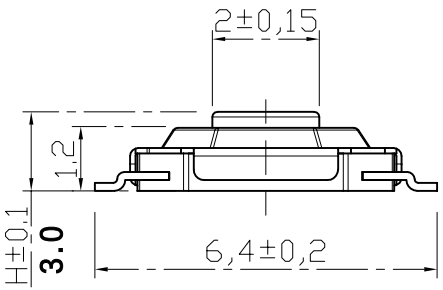
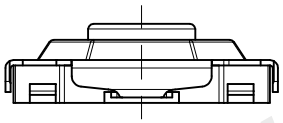
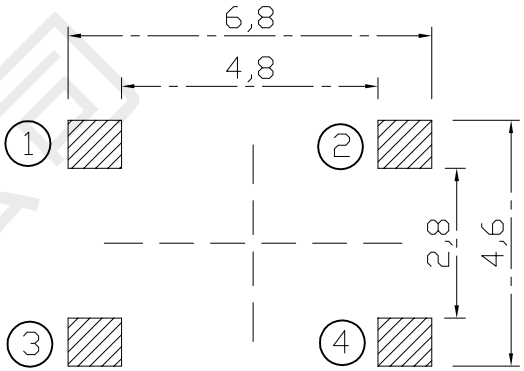
RoHs

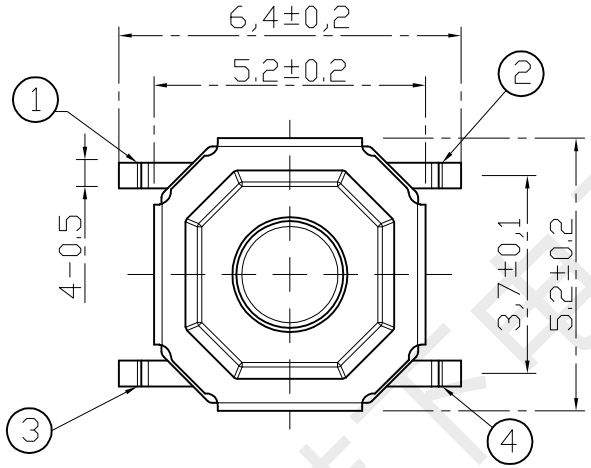


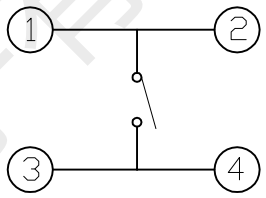






PCB. 焊接图





电 路 图

H	
1.5	1.6
1.7	2.0
2.5	3.0
3.5	4.0
4.5	5.0
5.5	6.0
6.5	7.0
7.5	8.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V　　2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 行　　程: 0.25±0.10mm　　4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 抗电强度: 100V 50HZ 1Min.　6. 寿　　命: 100,000 Cycles

操 作 力	250gf±50gf

序号	名称	数量	材料	备注
5	按钮	1	黄铜	酸洗
4	盖板	1	304不锈钢	清洗
3	膜	1	聚酰亚胺	
2	弹片	1	不锈钢301	镀银
1	本体	1	LCP +黄铜卡件	灰色+镀银

CUSTOMER		GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		APPROVED BY:	TITLE:
				罗小春	轻触开关
SIZE	UNITS	X±0.50	X°±5.0°	CHECKED BY:	PART NO.:
A4	MM[INCH]	.X±0.35	.X°±3.0°	张伟	HX 5.2x5.2x3.0H
SCALE	REV.	.XX±0.25	.XX°±2.5°	DESIGN BY:	DWG NO.:
1:1	1	.XXX±0.15	.XXX°±2.0°	黄彬	

深圳市韩下电子有限公司

SHEET 1/1

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co.,Ltd
Tel:0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：**轻触开关**

规格型号 Part No：HX 5.2x5.2x3.0H

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司

1.基本说明

1.1 范围

此规范含盖单推柄和无推柄的轻触开关要求

1.2 使用温度范围

-20 to65℃正常湿度，标准压力

1.3 保存温度范围

-25 to70℃

1.4 测试条件

测试和计量按下列标准条件除非特殊说明

标准温度：5~30℃

正常湿气：45~85%

标准压力：860~1060 mbars

2.外形,类型和尺寸

2.1 外形

外形必须无缺陷才不影响产品适用性

2.2 类型和尺寸

符合装配图

3.动作类型

轻触返回

4. 接触形式 1 接点 1 回路

接点形式在装配图中

5. 最大额定值

DC12V 50mA

6. 电性能

	项 目	试 验 方 法 及 特 性	规 格 及 要 求
6.1	**接触电阻**	用两倍的动作力作静负载施加于按钮的中心,并用 1 千赫小电流接触电阻仪测量	≤100mΩ
6.2	**绝缘电阻**	在端子与端子之间,端子与外壳之间施加 DC100V,一分钟	≥100MΩ
6.3	**电气耐压**	在端子与端子之间,端子与外壳之间施加 AC100V(50HZ-60HZ)	无击穿或飞孤

7. 机械性能

	项 目	试 验 方 法 及 特 性	规 格 及 要 求
7.1	**动作力**	开关的动作方向为垂直放置开关向推柄中心逐渐地增加负荷直到推柄停止时所测量的最大负荷	250±50gf
7.2	**动作寿命**	阻性负载:DC5V 5mA 动作频率:1-2 次/每秒 260gf 乘以 1.5 倍压力 动作次数: 10×10^4	测试后：动作力-50%初始动作力 并满足 6.1,6.2 测试要求

深圳市韩下电子有限公司

7.3	**推柄的强度**	开关的动作方向为垂直放置开关,从推柄动作方向反方向施加拉力所测量到的最大承受力	≥1.5 kg
7.4	**静止强度**	开关的动作方向为垂直放置开关,在推柄动作方向施加 1.5KG 的静负荷,60 秒时间	无机械的和电气的损伤迹象

8. 环境性能要求

	项　目	试 验 方 法 及 特 性	规　格 及 要 求
8.1	**耐热**	在温度 60°±2° 相对湿度 90~95%的恒温恒湿试验机里放置 48 小时拿出后，待常温下 2 小时后测试电性能。	满足 6.1，7.1 测试要求。
8.2	**耐低温**	在温度-20°±3° 的恒温试验机里放置 48 小时拿出后，待常温下 2 小时后测试性能。	满足 6.1，7.1 测试要求,
8.3	**盐雾试验**	在温度 35±2℃，连续喷雾重量浓度比为 5±1%的 NaCl 溶液中放置 4 小时。	端子与端子部位间电阻：1Ω 以下 开关通断部位间电阻：1Ω 以下
8.4	**耐潮湿**	在温度 40°±5°相对湿度 90 ±5%的条件下放置 48 小时拿出后，待常温下 2 小时后测试性能。	满足 6.1，7.1 测试要求。
8.5	**焊接性**	锡炉温度：235℃±5℃ 时间:5 秒±1 秒	焊接面积 90％以上
8.6	**焊 接 耐 热 性**	预热：在 P.W.B(印刷线路板)进入焊接设备后，2±0.3 分钟内铜箔表面要达到 180℃ 焊接温度： 在 P.W.B(印刷线路板)进入焊接温区 5 秒内，铜箔表面达到峰值温度 260℃	表面无起泡,变型

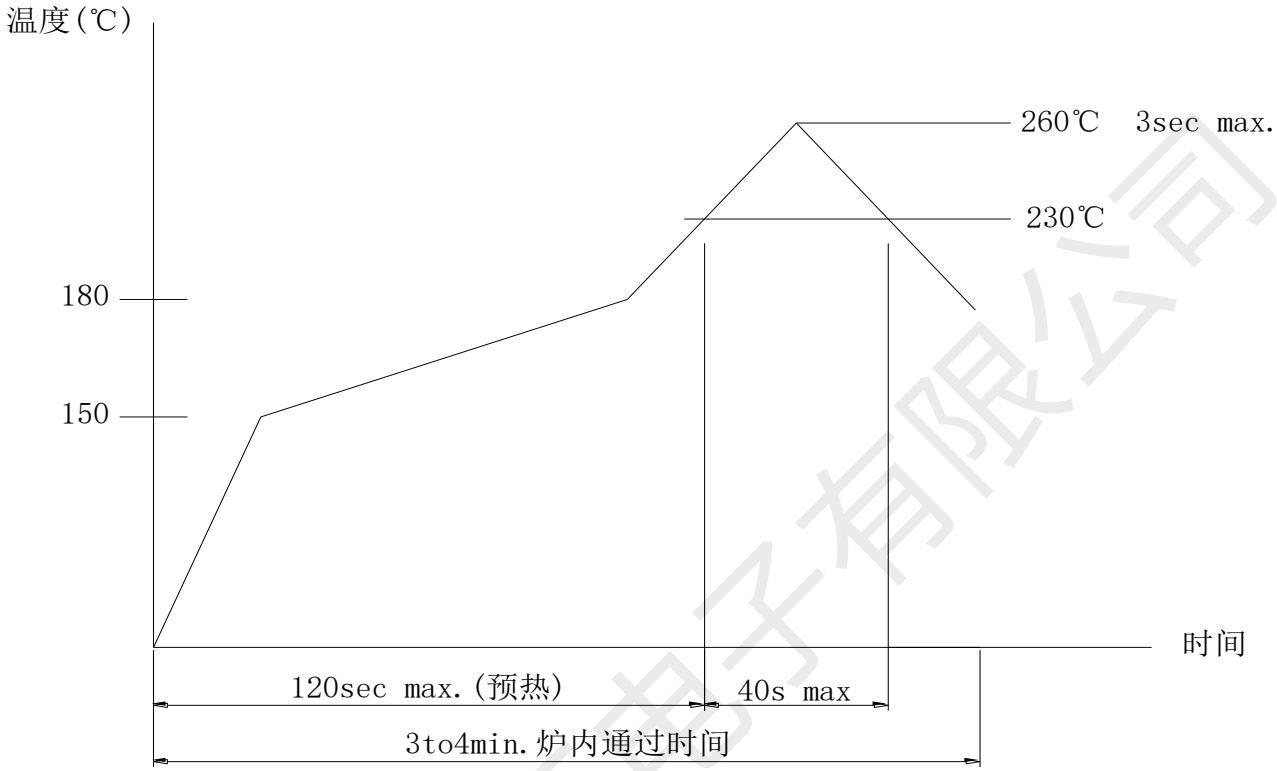
9. 焊接条件

9.1 手焊式

项目	条件
手工焊接温度	350±20℃max.
连接焊接时间	3±1S max.
焊剂斗容量	60W max.

9.2 回流焊

[适用表面贴装型产品]



(2 - 15)

1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA（K）或 CC（T）测量位置在焊接连接部（锡/铜箔面）。
3. 固定方式: 采用耐热胶带。
4. 温度分布: （图 2-15）

9.3自动浸焊式

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100℃ max.
预热温度时间	60S max.
焊接温度	260℃ max.
焊接浸渍时间	5S max.
焊接次数	2 次以下